

第86回レーザー加工学会講演会 平成28年12月12日(月) 岡山大学 五十周年記念館

金光ホール			
10:30	開会の辞	石出 孝 (三菱重工(株))	
10:35	ポスターショー・プレゼンテーション + 11:25~ポスタープレゼンテーション(交流サロン)	ポスター展示	カタログ展示
	ポスター発表		
1	レーザー金属積層造形におけるTi合金粉末の熔融挙動観察とスパッタ発生メカニズムの解明	山縣 秀人(大阪大学)	株式会社タマリ工業
2	直噴型レーザークラディング法によるステライト皮膜の形成と熔融挙動の実時間測定	佐藤 雄二(大阪大学)	山本光学株式会社
3	青色半導体レーザーを用いたレーザークラディング装置の開発と純銅皮膜の形成	仙石 正則(近畿大学)	スペクトロニクス株式会社
4	高はんだ接合性金ナノ粒子レーザー焼結膜の形成	赤荻 怜(茨城大学)	株式会社写真化学
5	レーザー焼結用銅マイクロ粒子トナーの開発とそのレーザー焼結特性	理崎 圭祐(茨城大学)	株式会社ワイ・イー・データ
6	フェライト/エポキシ樹脂基板への銅マイクロ粒子レーザー焼結法とパワーインダクタ製造技術への応用	渥美 良亮(茨城大学)	株式会社プロフィット
7	金属と樹脂のレーザー接合における押さえ圧が接合強度に及ぼす影響	大屋 暹平(名古屋工業大学)	株式会社ファインシス
8	金属と樹脂のレーザー接合における樹脂流入深さと接合強度の関係	内藤 崇文(名古屋工業大学)	santec 株式会社
9	ステンレス鋼のファイバレーザー溶接におけるハブリアンプロット結果に関する考察	部谷 学(大阪産業大学)	
10	純チタンの横向きリモートレーザー溶接における広範囲アルゴンガスシールド法	横原 和男(岡山大学)	
11	CFRPの切断時にレーザーアブレーションが材料表面に与える影響に関する数値計算	大久保 友雅(東京工科大学)	
12	ナノ秒レーザーによる銀ナノワイヤ透明導電膜の低視認性プロセスの検討	大下 雅史(岡山大学)	
13	近赤外パルスレーザー照射におけるレーザーピーニング効果	張 昆(近畿大学)	
14	アルミニウム合金A5052に対するレーザーピーニング	豊蔵 森(近畿大学)	
15	走査方法によるフェムト秒レーザーピーンフォーミングの曲げ効率の向上	鷺坂 芳弘(浜松工業技術支援センター)	
16	ガラスの微細レーザー溶接における開口数の影響	太田 元基(岡山大学)	
17	フェムト秒レーザーを用いたガラスの穴あけ加工における表面状態の観察	篠本 凜(東京大学)	
18	フェムト秒レーザーを用いたPET-Ti界面へのナノ周期構造形成	大賀 隆寛(大阪大学)	
屋食休憩 (12:40~13:40)			
金光ホール			
	プレナリーセッション		
13:40	【基調講演1】次世代型産業用3Dプリンタ技術開発 及び超精密三次元造形システム技術開発	橋谷 道明 (技術研究組合 次世代3D積層造形技術総合開発機構)	
	プレナリーセッション		
14:20	【基調講演2】レーザー加工用先進的ビーム創成・操作技術の現状	鷲尾 邦彦 (有限会社パラダイムレーザーリサーチ)	
Coffee break (15:00~15:10)			
金光記念ホール		2階 会議室	
	12A1:輸送機器製造のレーザー技術 ー自動車、船舶、航空分野のレーザー加工技術ー	Chair :木谷 靖(JFEスチール(株))	12B1:レーザーの光を創り操る新技術 Chair: 三瓶 和久 ((株)タマリ工業)
15:10	【特別講演】我が国の造船分野におけるレーザー・アークハイブリッド溶接技術導入に関する業界共同研究の動向	後藤 浩二(九州大学)	15:10 半導体レーザーを用いた光整形技術によるレーザー加工への適用
15:50	インテリジェントレーザーブランキングシステムの開発	深海 健一(ホンダエンジニアリング(株))	15:40 LCOS-SLMを用いたワンショットレーザー微細加工装置
16:20	Laser welded plastic tailgate deployment	Hichame Roumadni (Renault SAS)	16:10 回転ビームによる微細穴加工
16:50	自動車・航空機分野で適用される高出力ファイバーレーザーの最新技術と加工事例	菊地 淳史(IPGフォトリニクスジャパン(株))	16:40 Novel beam delivery systems for high efficiency UV DPSS laser processing
17:20	1日目終了		17:10 1日目終了
17:40	懇親会 (ピーチユニオン4Fレストラン 17:40~19:40) ポスター発表 優秀賞発表		

第86回レーザ加工学会講演会 平成28年12月13日(火) 岡山大学 五十周年記念館

金光ホール		2階 会議室	
13A1:レーザ溶接のその場計測		13B1:生体適合性微小材料のレーザ操作	
Chair: 佐野智一(大阪大学)		Chair: 細川陽一郎 (奈良先端科学技術大学院大学) 渡邊 歴(立命館大学)	
9:30	【特別講演】 レーザ加工技術高度化のための放射光X線その場観察計測	9:30	【特別講演】 近赤外光と金ナノ粒子を組み合わせたドラッグデリバリーシステム
葛蒲 敬久 (日本原子力研究開発機構)		新留 琢郎(熊本大学)	
10:10	その場X線回折によるTIG溶接時の相変態と応力測定	10:10	光ピンセットによる空気中に浮遊する単一微小液滴の操作
平野 辰巳((株)日立製作所)		石坂 昌司(広島大学)	
10:40	X線その場観察と粒子法を用いたレーザ溶接時のキーホール形成機構説明	10:40	超短パルスレーザと生分解性ポリマーの相互作用およびドラッグデリバリーへの応用
川人 洋介(大阪大学)		寺川 光洋(慶應義塾大学)	
11:10	ピコ秒パルスレーザによるガラスの微細熔融溶接の安定化	11:10	フェムト秒レーザ誘起衝撃力を駆使した高速細胞分取
岡本 康寛(岡山大学)		飯野 敬矩 (奈良先端科学技術大学院大学)	
昼食休憩(11:40~12:30)			
第87回講演会実行委員会(11:50~12:20)			
金光ホール		2階 会議室	
13A2:レーザ加工とIoT		13B2:半導体/電子産業のレーザ加工	
Chair: 渡辺 俊哉(三菱重工(株))		Chair: 福満 憲志(浜松ホトニクス(株))	
12:30	【特別講演】 IoT活用ものづくりとつながる工場でのレーザ加工	12:30	【特別講演】 高出力半導体レーザの開発現況と電子産業への応用事例
加納 誠介(産業技術総合研究所)		渡邊 正樹(浜松ホトニクス(株))	
13:10	レーザー加工の情報化への取り組み	13:10	SiCの高速レーザーサイジング技術の開発
溝辺 浩史(トルンプ(株))		高橋 邦充((株)ディスコ)	
13:40	Coherent社のイーサネットによるリモート診断機能の充実化と、高速パワー/エネルギー測定による生産性向上の事例	13:40	レーザによる薄膜積層のトリミング技術開発
只隈 和博(コヒーレント・ジャパン(株))		森 英治(東レエンジニアリング(株))	
14:10	レーザ加工機リモートサービス“iQ Care Remote4U”のご紹介	14:10	レーザ加工を活用したPrint and Imprint法
高田 浩子(三菱電機(株))		中村 貴宏(東北大学)	
Coffee break(14:40~14:50)			
金光記念ホール		2階 会議室	
13A3:多様なレーザアプリケーション		13B3:アディティブマニュファクチャリング	
Chair: 岡本 康寛(岡山大学)		Chair: 田中健一郎(パナソニック(株))	
14:50	レーザ・アークハイブリッド溶接の海上保安庁向け大型巡視船への適用	14:50	高付加価値セラミックス造形技術の開発 -3D積層造形技術-
木村 陵介(三井造船(株))		大司 達樹(産業技術総合研究所)	
15:20	8 kW Adjustable Ring Mode Laser Opens New Possibilities in Welding and Cutting	15:20	切削不要・微細成形が可能な高機能石英ガラス
Jarno Kangastupa(Corelase Oy)		藤野 茂(九州大学)	
15:50	レーザ照射とめっきによるパワー半導体ガラス基板のマスクレス配線工法開発	15:50	セラミックス用高精細レーザ造形装置
水戸岡 豊 (岡山県工業技術センター)		法貴 哲夫((株)写真化学)	
16:20	マイクロ流体チップへのフェムト秒レーザ加工による局所親水性表面の作製と微小液滴の制御	16:20	光造形法によるセラミックスの3次元積層造形技術の開発
合谷 賢治(産業技術総合研究所)		横田 耕三(香川県産業技術センター)	
16:50	終了		